

設備名稱：晶片製冷水冷扇  
Equipment name

型號（型式）：HWF-10JL010  
Type designation (Type)

10JL010-HWF、10JL020-HWF、10JL030-HWF、10JL040-HWF、10JL050-HWF、10JL060-HWF、10JL070-HWF  
10JL080-HWF、10JL090-HWF、HWF-10JL010、HWF-10JL020、HWF-10JL030、HWF-10JL040、HWF-10JL050、  
HWF-10JL060、HWF-10JL070、HWF-10JL080、HWF-10JL090

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼組件	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
遙控器組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.